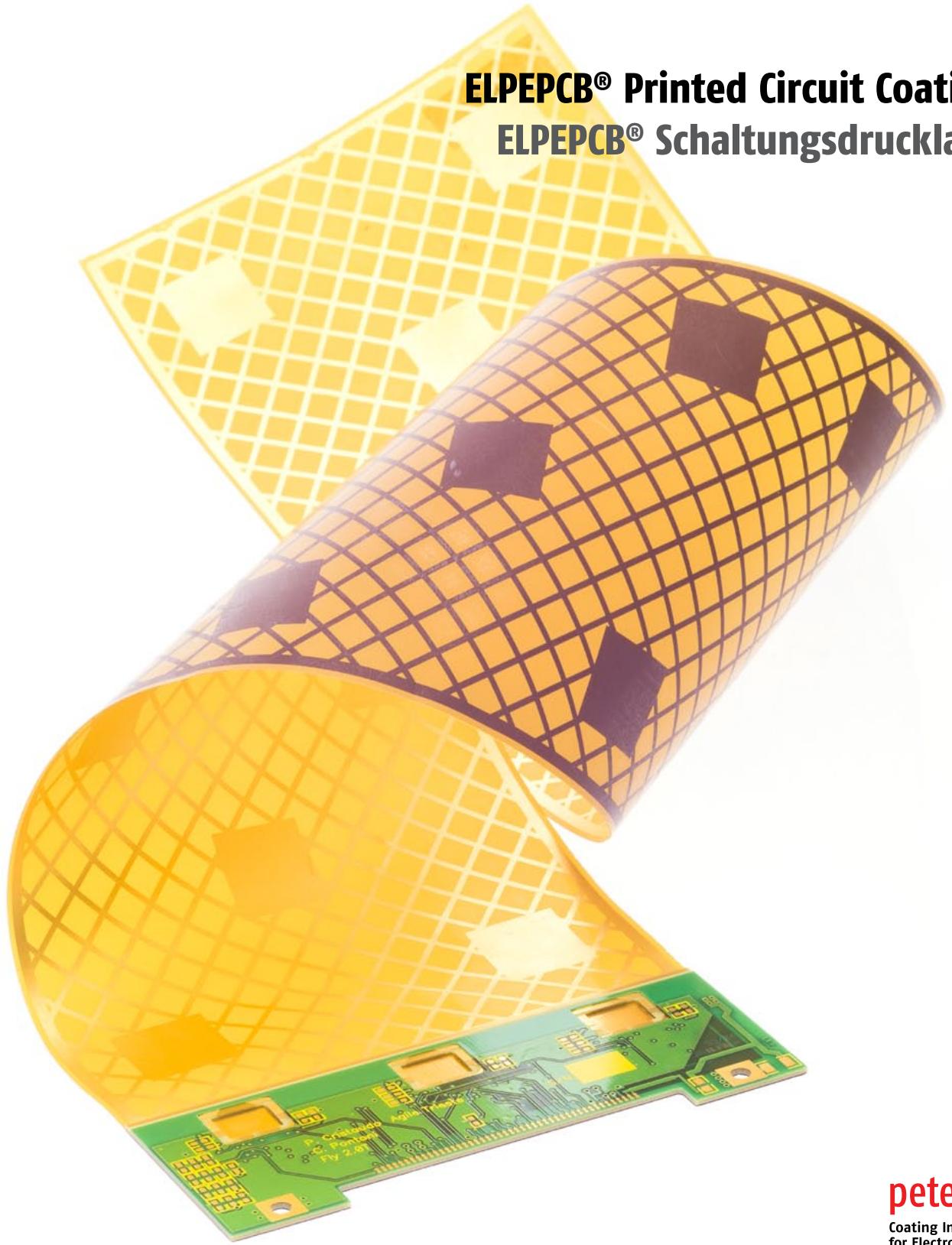


ELPEPCB®

peters

ELPEPCB® Printed Circuit Coatings **ELPEPCB® Schaltungsdrucklacke**

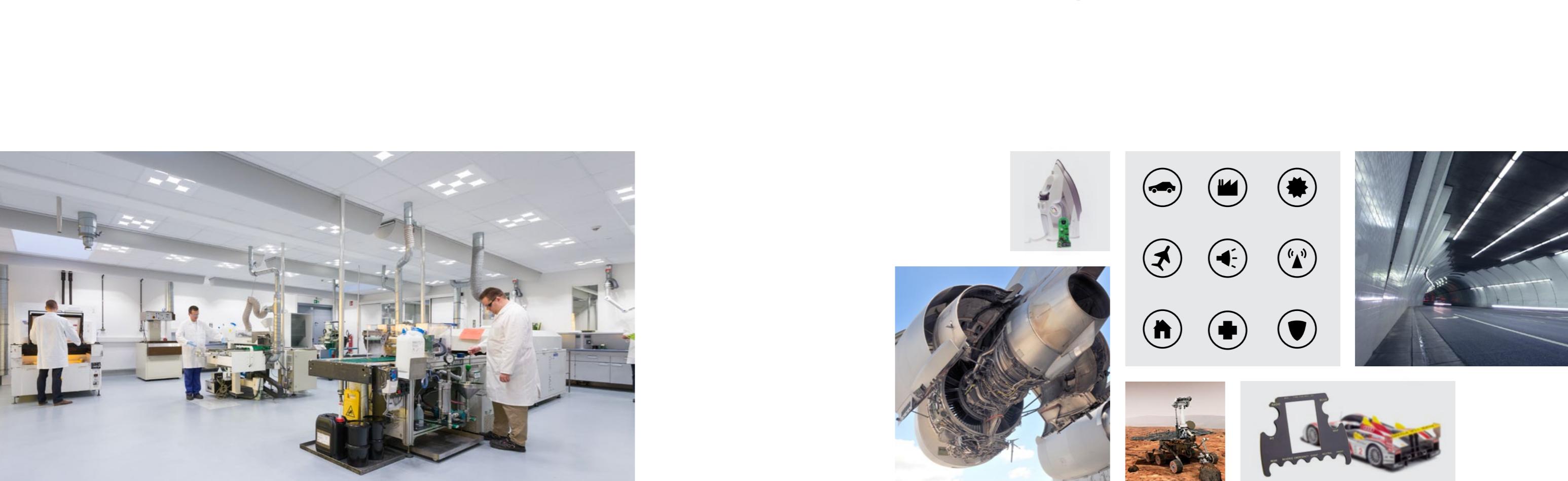


peters

Coating Innovations
for Electronics

The Peters Group

Die Peters Gruppe



The Peters Group, based in Kempen, Germany, is an independent family company and the only complete coatings supplier for electronics in the world.

From coatings for the manufacture of printed circuit boards and the protection of assembled printed circuit boards/electronic components to integrated coating technology solutions, Peters is a global leader in the field of electronics-related high-tech coatings for automotive electronics, aerospace engineering, industrial electronics, medical technology, LED applications and other industries.

For over 40 years we have been working closely with our customers to present revolutionary and practical solutions. Our highly specialized research & development division guarantees the continuous concept and improvement of innovative products.

With our international distribution offices and more than 65 regional representative offices worldwide, we are a competent on-site partner in over 90 countries serving more than 3,500 customers globally.

Die Peters Gruppe mit Sitz in Kempen am Niederrhein ist ein unabhängiges Familienunternehmen und der weltweit einzige Komplettanbieter von Beschichtungsstoffen für die Elektronik.

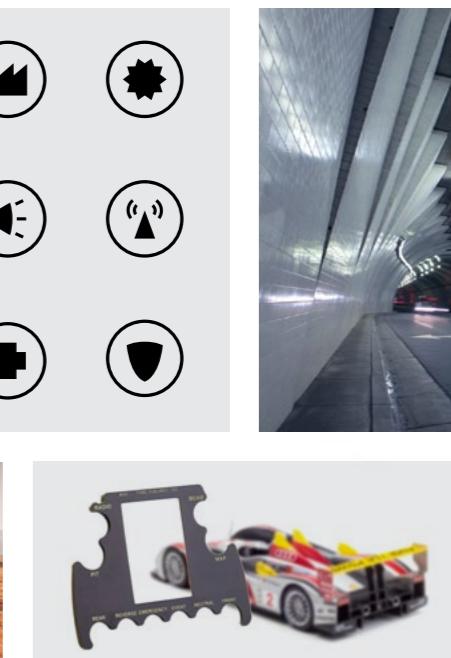
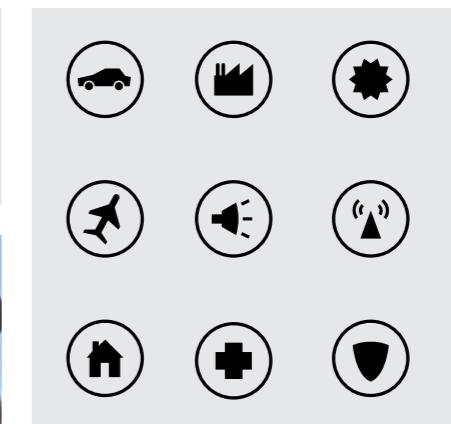
Als Anbieter von Beschichtungen für die Herstellung von Leiterplatten und den Schutz von Baugruppen und elektronischen Bauteilen bis hin zu integrierten Lösungen für die Beschichtungstechnologie ist die Peters Gruppe führend im Bereich High-Tech-Beschichtungen für die Elektronik, die in der Automobilelektronik, Luft- und Raumfahrt, Industrielektronik und Medizintechnik sowie bei LED-Anwendungen und weiteren Industrie-Applikationen eingesetzt werden.

Seit über 40 Jahren erarbeiten wir – in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden – richtungsweisende und praxisorientierte Lösungen. Unser hochspezialisiertes Forschungs- und Entwicklungsteam ist Garant für ständige Neu- und Weiterentwicklungen innovativer Produkte.

Mit unseren internationalen Vertriebsbüros und mehr als 65 Auslandsvertretungen sind wir in mehr als 90 Ländern für >3.500 Kunden der kompetente Partner vor Ort.

Solutions

Lösungen

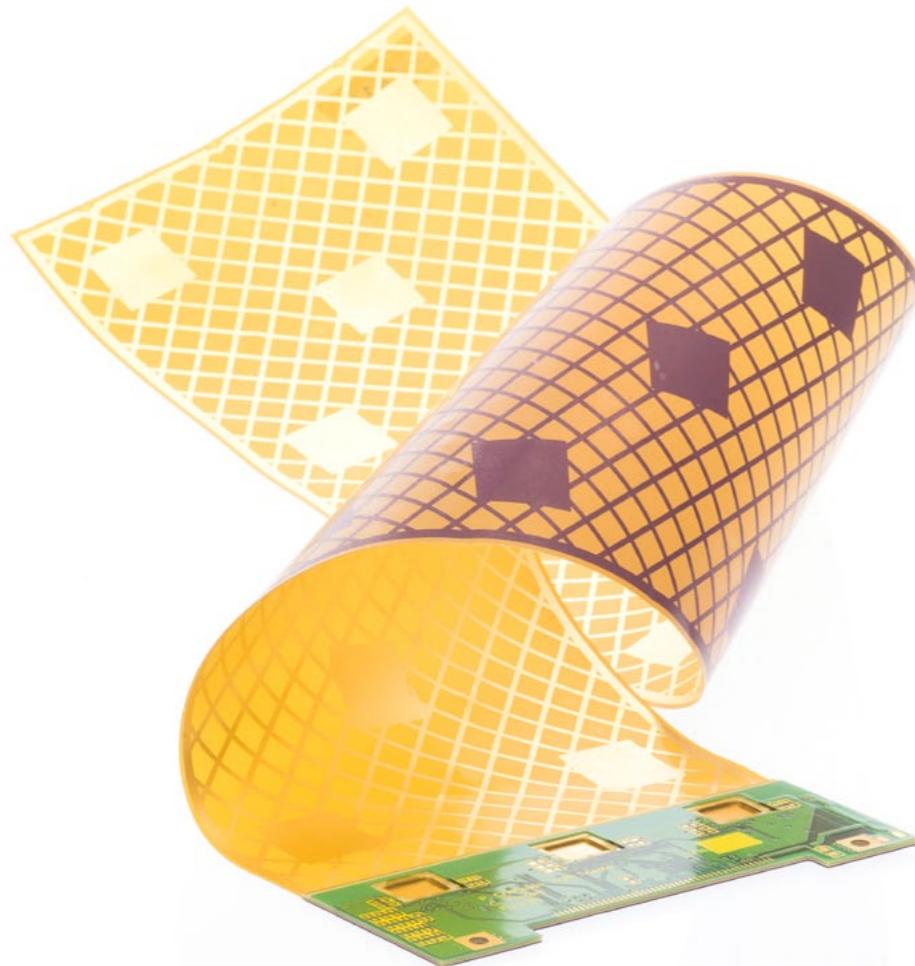


As a specialist in coating materials the Peters Group provides competent and reliable solutions for

- > Automotive Electronics
- > Aerospace Electronics
- > Consumer Electronics
- > Industrial Electronics
- > Lighting Electronics
- > Medical Technology
- > Solar Technology
- > Telecommunication
- > Defense Electronics

Als Spezialist für Beschichtungen für die Elektronik bietet die Peters Gruppe kompetente und zuverlässige Lösungen für:

- > Elektronik im Automotivbereich
- > Luft- und Raumfahrtelktronik
- > Unterhaltungselektronik
- > Industrielektronik
- > Lichtelektronik
- > Medizintechnik
- > Solartechnologien
- > Telekommunikation
- > Verteidigung / Militärtechnologie



Printed Circuit Coatings

Schaltungsdrucklacke

ELPEPCB offers the complete range of printed circuit coatings which fulfil highest demands in PCB manufacturing.

ELPEPCB bietet das komplette Programm an Schaltungsdrucklacken, die höchste Anforderungen bei der Herstellung von Leiterplatten erfüllen.

Legend / Legende

Field of use Einsatzgebiet	Color Farbe
Automotive	Medical
Aerospace	Solar
Consumer	Communication
Industrial	Defense
Lighting	

Printed Circuit Coatings

Schaltungsdrucklacke

ELPEPCB® Etch resists, plating resists and Elpemer® photoresists

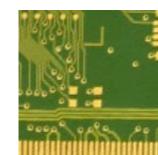
ELPEPCB® Ätz-, Galvanoresists und Elpemer® Fotoresists

For the creation of fine and ultra-fine trace images on inner and outer layers;
excellent adhesion and high surface hardness

zur Herstellung von feinen und feinsten Leiterstrukturen auf Innen- und Außenlagen;
ausgezeichnete Haftfestigkeit und hohe Oberflächenhärté

Product Series Produktserie	Features Merkmale	Colour Farbe
Elpemer® photoresist Elpemer® Fotoresists	Excellent resolution, capable of representing ultra-fine traces < 50 µm; very low exposure energy; quick to dry; for all standard application processes; strippable in filterable flakes, promoting reduced waste water contamination and longer standing time of the stripper solution	
	hervorragendes Auflösungsvermögen, auch feinste Leiter < 50 µm darstellbar, sehr geringe Belichtungsenergie und schnelle Trocknung; für alle gängigen Applikationsverfahren; strippbar in filterbare Fladen für eine reduzierte Abwasserbelastung und verlängerte Standzeit der Stripperlösung	
RC 2054 HR	<ul style="list-style-type: none"> Etch resist Application by roller coating, curtain coating, dip coating Marked colour change during exposure enables good visual inspection <p>Recommended auxiliary products Cleaning agents R 5821 and R 5817, Defoamant HP 5911 Empfohlene Hilfsprodukte Reinigungsmittel R 5821 und R 5817, Antischäummittel HP 5911</p>	●
SD 2054	<ul style="list-style-type: none"> Ätzresist Applikation im Walzacker-/Roller Coating-Verfahren, Vorhanggießverfahren, Tauchverfahren deutlicher Farbumschlag beim Belichten ermöglicht gute visuelle Kontrolle <p>Etch and plating resist Application by screen printing</p> <p>Recommended auxiliary products Screen opener HP 5200, Anti-static spray HP 5500, Cleaning agents R 5899, R 5821 and R 5817, Defoamant HP 5911 Empfohlene Hilfsprodukte Sieböffner HP 5200, Anti-Statik-Spray HP 5500, Reinigungsmittel R 5899, R 5821 und R 5817, Antischäummittel HP 5911</p>	●
Thermal curing etch and plating resists Thermisch härtende Ätz- und Galvanoresists	High-definition application by screen printing konturenscharfe Applikation im Siebdruck	
SD 2052 AL series	<ul style="list-style-type: none"> Etch resist Resistant to pH 9 Alkaline-strippable <p>Etch resist beständig bis pH 9 alkalisch strippbar</p>	● ●
SD 2149 SIT-HS	<ul style="list-style-type: none"> Plating resist for use in Secondary Imaging Technology (SIT), protects metal surfaces during electroless Ni/Au process (ENiG), thus enabling an additional OSP surface finish Good adhesion to copper and solder resists Alkaline strippable <p>Plating resist for use in Secondary Imaging Technology (SIT), schützt Metalloberflächen während des chemisch Ni/Au-Prozesses (ENiG) und ermöglicht eine zusätzliche OSP-Endoberfläche</p>	●

Product Series Produktserie	Features Merkmale	Colour Farbe
Aurosit 2149 series	<ul style="list-style-type: none"> Plating resists for use in Secondary Imaging Technology (SIT), protect metal surfaces during electroless Ni/Au process (ENiG), thus enabling an additional OSP surface finish Good adhesion to copper and solder resists Alkaline strippable <p>Recommended auxiliary products Screen opener HP 5200, Anti-static spray HP 5500, Cleaning agents R 5899, R 5821 and R 5817 Empfohlene Hilfsprodukte Sieböffner HP 5200, Anti-Statik-Spray HP 5500, Reinigungsmittel R 5899, R 5821 und R 5817</p>	●
SD 2154 E	<ul style="list-style-type: none"> Galvanoresists for the Einsatz in der Secondary Imaging Technology (SIT), schützen Metalloberflächen während des chemisch Ni/Au-Prozesses (ENiG) und ermöglicht so eine zusätzliche OSP-Endoberfläche gute Haftfestigkeit auf Kupfer und Lötstopplacken alkalisch strippbar <p>Elastic etch and plating resist also suitable for air drying Outstanding resistance over the whole pH range, also in cyanidic baths Solvent-strippable</p> <p>Recommended auxiliary products Screen opener HP 5200, Anti-static spray HP 5500, Cleaning agents R 5899, R 5821 and R 5817 Empfohlene Hilfsprodukte Sieböffner HP 5200, Anti-Statik-Spray HP 5500, Reinigungsmittel R 5899, R 5821 und R 5817</p>	●
UV curing etch and plating resists UV-härtende Ätz- und Galvanoresists	High-definition application by screen printing, alkaline-strippable konturenscharfe Applikation im Siebdruck, alkalisch strippbar	
SD 2050 UV	<ul style="list-style-type: none"> Etch and plating resist, resistant to pH 9 Capable of representing 150 µm structures Suitable to etch 400 µm thick copper <p>Recommended auxiliary products Anti-static spray HP 5500, Cleaning agents R 5899, R 5821 and R 5817 Empfohlene Hilfsprodukte Anti-Statik-Spray HP 5500, Reinigungsmittel R 5899, R 5821 und R 5817</p>	●
SD 2059 UV-AL-T	<ul style="list-style-type: none"> Etch and plating resist, resistant to pH 9 Capable of representing 150 µm structures <p>Recommended auxiliary products Anti-static spray HP 5500, Cleaning agents R 5899, R 5821 and R 5817 Empfohlene Hilfsprodukte Anti-Statik-Spray HP 5500, Reinigungsmittel R 5899, R 5821 und R 5817</p>	●
ELPEPCB® Solder resists / ELPEPCB® Lötstopplacke	Enable simultaneous "complete soldering" and selective soldering, compatible with lead-free soldering processes, for rigid, flex-rigid and flexible PCBs, excellent adhesion ermöglichen die sogenannte Komplett-Lötung bei gleichzeitig selektiver Lözung, kompatibel mit bleifreien Lötzprozessen, für starre, starr-flexible und flexible Leiterplatten, hervorragende Haftfestigkeit	
Product Series Produktserie	Features Merkmale	Colour Farbe
Photoimageable Elpemer® solder resist	Excellent resolution, capable of representing finest structures (ink dams), for all standard application processes, UL approvals in acc. with UL File No. E80315	
Fotostrukturierbare Elpemer® Lötstopplacke	hervorragendes Auflösungsvermögen, auch feinste Strukturen (Lackstege) darstellbar, für alle gängigen Applikationsverfahren, UL-Zulassungen gemäß UL File No. E80315	
SD 2463 FLEX-HF series	<ul style="list-style-type: none"> Application by screen printing, for printing on flexible base materials, aqueous-alkaline developable Excellent resolution down to 30 µm Halogen-free in acc. with JPCA-E501-2003 / IEC 61249-2-21 Fulfils/exceeds IPC-SM-840E <p>Application by screen printing, for the Druck auf flexiblen Basismaterialien, wässrig-alkalisch entwickelbar hervorragende Auflösung bis 30 µm halogenfrei gemäß JPCA-E501-2003 / IEC 61249-2-21 erfüllt/übertrifft IPC-SM-840E</p>	● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○



ELPEPCB® Solder resists / ELPEPCB® Lötstopplacke

Enable simultaneous "complete soldering" and selective soldering, compatible with lead-free soldering processes, for rigid, flex-rigid and flexible PCBs, excellent adhesion

ermöglichen die sogenannte Komplett-Lötung bei gleichzeitig selektiver Lözung, kompatibel mit bleifreien Lötzprozessen, für starre, starr-flexible und flexible Leiterplatten, hervorragende Haftfestigkeit

Product Series Produktserie	Features Merkmale	Colour Farbe
Photoimageable Elpemer® solder resist	Excellent resolution, capable of representing finest structures (ink dams), for all standard application processes, UL approvals in acc. with UL File No. E80315	
Fotostrukturierbare Elpemer® Lötstopplacke	hervorragendes Auflösungsvermögen, auch feinste Strukturen (Lackstege) darstellbar, für alle gängigen Applikationsverfahren, UL-Zulassungen gemäß UL File No. E80315	
SD 2463 FLEX-HF series	<ul style="list-style-type: none"> Application by screen printing, for printing on flexible base materials, aqueous-alkaline developable Excellent resolution down to 30 µm Halogen-free in acc. with JPCA-E501-2003 / IEC 61249-2-21 Fulfils/exceeds IPC-SM-840E <p>Application by screen printing, for the Druck auf flexiblen Basismaterialien, wässrig-alkalisch entwickelbar hervorragende Auflösung bis 30 µm halogenfrei gemäß JPCA-E501-2003 / IEC 61249-2-21 erfüllt/übertrifft IPC-SM-840E</p>	● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○

Printed Circuit Coatings

Schaltungsdrucklacke

Product Series Produktserie	Features Merkmale	Colour Farbe
2467 series	<ul style="list-style-type: none"> For all standard application processes, aqueous-alkaline developable Outstanding thermo-mechanical properties with respect to thermal cycling resistance and permanent/high-temperature resistance Fulfils/exceed amongst others IPC-SM-840E, NASA outgassing test in acc. with ASTM E595; resistant to mould and noxious gases Halogen-free adjustments in acc. with JPCA-ES01-2003 / IEC 61249-2-21 DI versions for direct imaging <p>Empfohlene Hilfsprodukte Sieböffner HP 5200, Anti-Statik-Spray HP 5500, Spezial-Stripper HP 5707, Reinigungsmittel R 5899, R 5821 und R 5817, Defoamant HP 5911</p>	
2469 SM-HF series	<ul style="list-style-type: none"> For all standard application processes, extremely wide processing window, developable in carbitol or butyl carbitol Outstanding thermo-mechanical properties with respect to thermal cycling resistance and permanent/high-temperature resistance Fulfils/exceed amongst others IPC-SM-840E, resistant to mould and noxious gases Halogen-free in acc. with JPCA-ES01-2003 / IEC 61249-2-21 <p>Empfohlene Hilfsprodukte Sieböffner HP 5200, Anti-Statik-Spray HP 5500, Spezial-Stripper HP 5707, Reinigungsmittel R 5899, R 5821 und R 5817</p>	
2491 TSW series	<ul style="list-style-type: none"> For all standard application processes, aqueous-alkaline developable Very resistant to yellowing, even after lead-free reflow soldering processes and high thermal load, low ΔE values, in particular Δb values Halogen-free in acc. with JPCA-ES01-2003 / IEC 61249-2-21 Cracking resistant in thermal shock test (TCT -40 to +125 °C) <p>Empfohlene Hilfsprodukte Sieböffner HP 5200, Anti-Statik-Spray HP 5500, Spezial-Stripper HP 5707, Reinigungsmittel R 5899, R 5821 und R 5817, Antischäummittel HP 5911</p>	

Product Series Produktserie	Features Merkmale	Colour Farbe
Thermal curing solder resists Thermisch härtende Lötstopplacke	High-definition application by screen printing, UL approvals in acc. with UL File No. E80315	
SD 2444 NB-M	<ul style="list-style-type: none"> Excellent resistance to soldering processes ausgezeichnete Beständigkeit in Lötprozessen <p>Empfohlene Hilfsprodukte Sieböffner HP 5200, Anti-Statik-Spray HP 5500, Cleaning agents R 5899, R 5821 und R 5817</p>	
SD 2446 I / SD 2496 TSW	<ul style="list-style-type: none"> Very good weathering and chalking resistance (QUV accelerated weathering test) Excellent colour resistance, even after lead-free reflow soldering and tempering processes, low ΔE values SD 2496 TSW: High reflectivity and exceptional yellowing resistance Halogen-free in acc. with JPCA-ES01-2003/IEC 61249-2-21 <p>Empfohlene Hilfsprodukte Sieböffner HP 5200, Anti-Statik-Spray HP 5500, Reinigungsmittel R 5899, R 5821 und R 5817</p>	
SD 2462 NB / SD 2462 NB-M series	<ul style="list-style-type: none"> Excellent definition and superior conductor edge (knee) coverage SD 2462 NB-M is especially suitable as a "top coat" for thick copper technology (e.g. 400 µm technology, see also thick film fillers) Excellent chemical resistance <p>Empfohlene Hilfsprodukte Sieböffner HP 5200, Anti-Statik-Spray HP 5500, Reinigungsmittel R 5899, R 5821 und R 5817</p>	
UV curing solder resists UV-härtende Lötstopplacke	High-definition application by screen printing, for "print and etch", UL approvals in acc. with UL File No. E80315	
SD 2368 UV series	<p>Empfohlene Hilfsprodukte Anti-Statik-Spray HP 5500, Cleaning agents R 5899, R 5821 und R 5817</p> <ul style="list-style-type: none"> Cure thoroughly even in thicker layers Suitable for Hot-Air Levelling SD 2348 UV-SM is halogen-free in acc. with JPCA-ES01-2003 / IEC 61249-2-21 	
SD 2460/201 UV-FLEX series	<p>Empfohlene Hilfsprodukte Anti-Statik-Spray HP 5500, Reinigungsmittel R 5899, R 5821 und R 5817</p> <ul style="list-style-type: none"> Resistant to HAL and lead-free reflow soldering For flexible circuits, excellent adhesion to polyimide, polycarbonate and polyester foils For cross-over technology Halogen-free in acc. with JPCA-ES01-2003 and IEC 61249-2-21 (except SD 2460/201 UV-FLEX) 	

Printed Circuit Coatings

Schaltungsdrucklacke

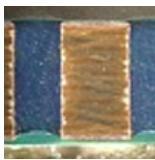


ELPEPCB® Peelable solder masks / ELPEPCB® Abziehbare Lötstopplacke

For the partial masking of PCBs as protection from direct contact with solder or as protection in electroplating processes, simple/high-definition application by screen printing, very high elasticity and tear resistance, easy to remove before and/or after the soldering process

zum partiellen Abdecken von Leiterplatten als Schutz vor direktem Kontakt mit dem Lot bzw. als Schutz in galvanischen Prozessen, einfache und konturenscharfe Applikation im Siebdruck, sehr hohe Elastizität und Einreibfestigkeit, einfache Entfernung vor und/oder nach dem Lötzprozess

Product Series Produktserie	Features Merkmale	Colour Farbe
SD 2950 series Recommended auxiliary products Cleaning agents R 5899, R 5821 and R 5817 Empfohlene Hilfsprodukte Reinigungsmittel R 5899, R 5821 und R 5817	<ul style="list-style-type: none"> For leaded or lead-free wave and reflow soldering and Hot-Air Levelling, some versions allow multiple soldering For printing over carbon-conductive ink Peelable from plated-through holes Suitable as masks in electroplating and other metallisation processes Unlimited pot/process life, solvent-free Recommended for the partial covering of assembled PCBs undergoing wave soldering: Peelable Solder Masks of the series PSM 13.990 für bleihaltige und bleifreie Wellen- und Reflow-Lötprozesse sowie Hot-Air-Levelling, teilweise Mehrfachlötzung möglich zum Überdrucken von Carbon-Leitlack abziehbar aus Durchkontaktierungen als Abdeckung in galvanischen und anderen Metallisierungsprozessen geeignet unbegrenzte Topf-/Verarbeitungszeit, lösemittelfrei empfohlen zum partiellen Abdecken bestückter Leiterplatten für Wellenlötprozesse: Peelable Solder Masks der Reihe PSM 13.990 	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>



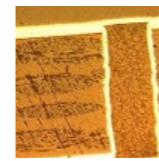
ELPEPCB® Via hole fillers / ELPEPCB® Durchsteigerfüller

Securely seal via holes for vacuum adaptation during incircuit testing, prevent solder from seeping to the component side and fluxers from settling in drill holes, UL approvals in acc. with UL File No. E80315, application by screen printing

zum sicheren Verschließen von Durchsteigern (Via Holes) für die Vakuumadaption beim Incircuit-Test, verhindern das Durchsteigen von Lötzinn auf die Bauteileseite und das Festsetzen von Flussmitteln in den Bohrungen, UL-Zulassungen gemäß UL File No. E80315, Applikation im Siebdruck

Product Series Produktserie	Features Merkmale	Colour Farbe
SD 2361 series Recommended auxiliary products Anti-static spray HP 5500, Cleaning agents R 5899, R 5821 and R 5817 Empfohlene Hilfsprodukte Anti-Statik-Spray HP 5500, Reinigungsmittel R 5899, R 5821 und R 5817	<ul style="list-style-type: none"> 100% solids content means virtually no volume shrinkage 1-pack system Thixotropic adjustment for larger drill holes (approx. 0.5-1 mm) nahezu kein Volumenschrumpf aufgrund des 100%igen Festkörpergehalts 1-Komponenten-System thixotrope Einstellung für größere Bohrungen (ca. 0,5-1 mm) 	<input checked="" type="radio"/>
Elpemer® VF 2467 DG Recommended auxiliary products Screen opener HP 5200, Anti-static spray HP 5500, Special stripper HP 5707, Cleaning agents R 5899, R 5821 and R 5817, Defoamant HP 5911 Empfohlene Hilfsprodukte Sieböffner HP 5200, Anti-Statik-Spray HP 5500, Spezial-Stripper HP 5707, Reinigungsmittel R 5899, R 5821 und R 5817, Antischäummittel HP 5911	<ul style="list-style-type: none"> Photoimageable 2-pack via hole filler Basically compatible with Elpemer® 2467 solder resist series Aqueous-alkaline developable fotostrukturierbarer 2-Komponenten-Durchsteigerfüller grundätzlich kompatibel mit den Lötstopplacken der Reihe Elpemer® 2467 wässrig-alkalisch entwickelbar 	<input checked="" type="radio"/>

Product Series Produktserie	Features Merkmale	Colour Farbe
SD 2768 NB Recommended auxiliary products Screen opener HP 5200, Anti-static spray HP 5500, Cleaning agents R 5899, R 5821 and R 5817 Empfohlene Hilfsprodukte Sieböffner HP 5200, Anti-Statik-Spray HP 5500, Reinigungsmittel R 5899, R 5821 und R 5817	<ul style="list-style-type: none"> High solids content means low volume shrinkage For via-in-pad applications, no bleeding on gold or other metal surfaces geringer Volumenschrumpf aufgrund des hohen Festkörpergehalts für Via-in-Pad-Anwendungen, kein Ausbluten auf Gold- oder andere Metalloberflächen 	<input checked="" type="radio"/>
Elpemer® VF 2469 SM-HF Recommended auxiliary products Screen opener HP 5200, Anti-static spray HP 5500, Special stripper HP 5707, Cleaning agents R 5899, R 5821 and R 5817 Empfohlene Hilfsprodukte Sieböffner HP 5200, Anti-Statik-Spray HP 5500, Spezial-Stripper HP 5707, Reinigungsmittel R 5899, R 5821 und R 5817	<ul style="list-style-type: none"> Photoimageable 2-pack via hole filler Basically compatible with the Elpemer® 2469 SM-HF solder resist series Developable in carbitol or butyl carbitol Halogen-free in acc. with JPCA-ES01-2003 / IEC 61249-2-21 fotostrukturierbarer 2-Komponenten-Durchsteigerfüller grundätzlich kompatibel mit den Lötstopplacken der Reihe Elpemer® 2469 SM-HF in Butyldiglykol (BDG) oder Ethyldiglykol (EDG) entwickelbar halogenfrei gemäß JPCA-ES01-2003 / IEC 61249-2-21 	<input checked="" type="radio"/>



ELPEPCB® Plugging pastes / ELPEPCB® Plugging-Pasten

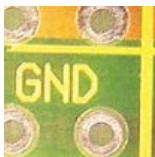
Bubble-free, smooth hole plugs/insulation layers in HDI/SBU technology, application by screen and stencil printing and vacuum screen printing, excellent metallisability, low thermal expansion coefficient, no cracking or delamination of the applied metallisation, UL approvals in acc. with UL File No. E80315

blasenfreie, ebene Lochfüllungen / Isolationsschichten in der HDI-/SBU-Technologie, Applikation im Sieb- und Schablonendruck und Vakuum-Siebdruck, ausgezeichnete Metallisierbarkeit, geringer thermischer Ausdehnungskoeffizient, keine Rissbildung oder Delamination der aufgebrachten Metallisierung, UL-Zulassungen gemäß UL File No. E80315

Product Series Produktserie	Features Merkmale	Colour Farbe
PP 2795 series Recommended auxiliary products Screen opener HP 5200, Anti-static spray HP 5500, Cleaning agents R 5899, R 5821 and R 5817 Empfohlene Hilfsprodukte Sieböffner HP 5200, Anti-Statik-Spray HP 5500, Reinigungsmittel R 5899, R 5821 und R 5817	<ul style="list-style-type: none"> Application also by roller coating Higher aspect ratios possible with high-viscosity adjustment Listed in NASA specification D-8202 Long shelf life: up to 6 months Applikation auch im Roller-Coating-Verfahren mit hochviskoser Einstellung können höhere Aspect Ratios realisiert werden gelistet in der NASA-Spezifikation D-8202 lange Haltbarkeit: bis zu 6 Monate 	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

Printed Circuit Coatings

Schaltungsdrucklacke



ELPEPCB® Marking inks / ELPEPCB® Signierlacke

Exceptional covering power, very good adhesion, soldering resistant, high solids content
ausgezeichnetes Deckvermögen, sehr gute Haftfestigkeit, lötbeständig, hoher Festkörpergehalt

Product Series Produktserie	Features Merkmale	Colour Farbe
Photoimageable Elpemer® marking inks	Blanket application by screen printing, especially suitable for pilot and low-volume series' as no complex screen stencil required, capable of representing finest details	○
Fotostrukturierbare Elpemer® Signierlacke	flächige Applikation im Siebdruck, für Null- und Kleinserien besonders geeignet, da die aufwendige Siebschablonenherstellung entfällt, Darstellung feinster Details	
SD 2691 TSW	<ul style="list-style-type: none"> Aqueous-alkaline developable Outstanding yellowing resistance even after reflow soldering and tempering processes, low ΔE values wässrig-alkalisch entwickelbar außerordentliche Vergilbungsbeständigkeit auch nach bleifreien Reflow-Löt- und Temperprozessen, geringe ΔE-Werte 	○
SD 2618 / SD 2698	<ul style="list-style-type: none"> Aqueous-alkaline developable wässrig-alkalisch entwickelbar 	○ ○
Thermal curing marking inks	High-definition application by screen printing	
SD 2696 TSW	<ul style="list-style-type: none"> Excellent yellowing resistance after lead-free reflow soldering and tempering processes, low ΔE values High reflectivity Very good weathering and chalking resistance (QUV accelerated weathering test) exzellente Vergilbungsbeständigkeit nach bleifreien Reflow-Löt- und Temperprozessen, geringe ΔE-Werte hohe Remission sehr gute Witterungs- und Kreidungsbeständigkeit (QUV Schnellbewitterungstest) 	○
SD 2692 T series	<ul style="list-style-type: none"> long pot/processing life: at least 6 weeks Catalysed adjustments cure faster, pot life 1 day Superior chemical resistance lange Topf-/ Verarbeitungszeit: mindestens 6 Wochen die katalysierten Einstellungen härten schneller, Topfzeit 1 Tag hervorragende chemische Beständigkeit 	○ ○ ○ ○ ○
SD 2617 series	<ul style="list-style-type: none"> long pot/processing life: at least 1 month lange Topf-/ Verarbeitungszeit: mindestens 1 Monat 	○

Product Series Produktserie	Features Merkmale	Colour Farbe
UV curing marking inks UV-härtende Signierlacke	High-definition application by screen printing konturenscharfe Applikation im Siebdruck	

SD 2513 UV series	<ul style="list-style-type: none"> Solids content 100% Short curing times High colour stability Festkörpergehalt 100% kurze Aushärtezeiten hohe Farbstabilität 	● ○ ○
-------------------	--	-------



ELPEPCB® Carbon-conductive inks / ELPEPCB® Carbon-Leitlacke

to substitute gold on contact points, also suitable for cross-over technology and for generating printed resistors

zur Substitution von Gold an Kontaktstellen, auch geeignet für die Herstellung von kreuzenden Leitern (Cross-Over-Technik) und das Erstellen gedruckter Widerstände

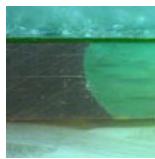
Product Series Produktserie	Features Merkmale	Colour Farbe
Carbon-conductive inks Carbon-Leitlacke	High-definition application by screen printing, very good adhesion to flexible base material, thus also suitable for "static flex" applications, excellent mechanical resistance, resistant to Hot-Air Levelling	

SD 2842 HAL	<ul style="list-style-type: none"> Ultra-smooth surface, thus also suitable for sliding contacts sehr glatte Oberfläche, daher auch geeignet für Schleifkontakte 	○
-------------	--	---

SD 2843 HAL	<ul style="list-style-type: none"> For touch-key contacts Individual resistances possible by mixing with insulating paste SD 2803 HAL für Tippkontakte durch Mischen mit der Isolierpaste SD 2803 HAL sind individuelle Widerstände einstellbar 	○
-------------	---	---

Printed Circuit Coatings

Schaltungsdrucklacke



ELPEPCB® Thick film fillers / ELPEPCB® Dickschichtfüller

Fill insulation channels in thick copper technology (e.g. 400 µm technology) by means of screen or stencil printing, solvent-free, very good soldering resistance also in lead-free soldering processes

zum Verfüllen der Isolationskanäle in der Dickkupfertechnik (z.B. der 400 µm-Technik) im Sieb- oder Schablonendruck, lösemittelfrei, sehr gute Lötbeständigkeit, auch in bleifreien Lötprozessen

Product Series Produktserie	Features Merkmale	Colour Farbe
DSF 2706 UV	<ul style="list-style-type: none"> UV curing 2-pack system UL approval in acc. with UL 94, UL File No. E80315 Halogen-free in acc. with JPCA-ES01-2003 / IEC 61249-2-21 For use on outer layers System component in thick copper technology in combination with the 2-pack solder resist SD 2462 NB-M as "top coat" <p>Recommended auxiliary products Cleaning agents R 5899, R 5821 and R 5817 Empfohlene Hilfsprodukte Reinigungsmittel R 5899, R 5821 und R 5817</p>	🕒
DSF 2793	<ul style="list-style-type: none"> Thermal curing 1-pack system For the generation of thick-copper inner layers Corresponds to the best flame class V-o in acc. with UL 94 <p>Recommended auxiliary products Screen opener HP 5200, Anti-static spray HP 5500, Cleaning agents R 5899, R 5821 and R 5817 Empfohlene Hilfsprodukte Sieböffner HP 5200, Anti-Statik-Spray HP 5500, Reinigungsmittel R 5899, R 5821 und R 5817</p>	🕒



ELPEPCB® Thermal transfer pastes / ELPEPCB® Wärmeleitpasten

Highly thermally conductive systems for the thermal management of pcbs pcb assemblies, cost-effective alternative to conventional glued heatsinks, flexible design of different heatsink geometries with existing screen printing technology, electrically insulating

sehr wärmeleitfähige Systeme für das thermische Management von Leiterplatten / Flachbaugruppen, kostengünstige Alternative zum konventionellen aufgeklebten Heatsink, flexible Gestaltung unterschiedlichster Heatsinkgeometrien mit bestehender Siebdrucktechnik, elektrisch isolierend

Product Series Produktserie	Features Merkmale	Colour Farbe
Heatsink pastes Heatsink-Pasten		
HSP 2740 / HSP 2741	<ul style="list-style-type: none"> 1-pack systems with 100% solids content HSP 2740: Excellent printing properties, silk-mat surface and better chemical resistance HSP 2741: Higher flexibility, thus less impact on the evenness of the pcb; UL approval in acc. with UL File No. E80315 <p>Recommended auxiliary products Cleaning agents R 5899, R 5821 and R 5817 Empfohlene Hilfsprodukte Reinigungsmittel R 5899, R 5821 und R 5817</p>	🕒

Product Series Produktserie	Features Merkmale	Colour Farbe
Thermal interface paste Thermal Interface Paste		

TIP 2792	<ul style="list-style-type: none"> 1-pack system with 100% solids content is applied as Thermal Interface Material (TIM) between the printed circuit board and the heatsink or heat-dissipating casings for a reliable thermal connection for thermo-mechanical decoupling 	🕒
	<ul style="list-style-type: none"> 1-Komponenten-System mit 100% Festkörpergehalt wird als Thermal Interface Material (TIM) zwischen Leiterplatte und Kühlkörper oder wärmeableitenden Gehäusen für eine zuverlässige thermische Anbindung eingesetzt zur thermomechanischen Entkopplung 	



Unsere Innovationen für Ihren Erfolg Our innovations for your success

Lackwerke Peters GmbH & Co. KG
Hooghe Weg 13 • 47906 Kempen • Germany
Phone: +49 2152 2009-0
Fax: +49 2152 2009-70
www.peters.de

peters
Coating Innovations
for Electronics